**BGA Input**

**Use Case**

**修订历史**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 章节名称 | 变更原因 | 变更内容描述 | 变更日期 | 版本 |
| ALL | ALL | 新需求 | MBCode升级，统一修改 | 2012-5-18 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目录**

[1. 前言 4](#_Toc308420537)

[1.1. Introduce 4](#_Toc308420538)

[1.2. References 4](#_Toc308420539)

[2. Use Cases 5](#_Toc308420540)

[2.1. UC-BGA Input 5](#_Toc308420541)

[2.1.1. 功能及目标 5](#_Toc308420542)

[2.1.2. 前置条件 5](#_Toc308420543)

[2.1.3. 后置条件 5](#_Toc308420544)

[2.1.4. 过程描述 5](#_Toc308420545)

[2.1.5. 业务规则 5](#_Toc308420546)

[Appendix 7](#_Toc308420547)

[Question 7](#_Toc308420548)

# 前言

## Introduce

本文档用于定义[SA BGA Input] 部分的业务需求，作为规格设计与程序设计的依据；读者为iMES 2012项目的用户，设计人员，开发人员和质检人员。

## References

# Use Cases

## UC-BGA Input

### 功能及目标

更换主板器件的入口。

### 前置条件

主板需要更换器件，如南桥、北桥、CPU Socket等。

### 后置条件

主板更换以后，记录更换信息。

### 过程描述

|  |  |
| --- | --- |
| **UI** | **System** |
| 1. Scan [MB Sno] |  |
|  | 1. SFC |
|  | 1. Display [MB Sno] and Get [Repair List] By [MBSno] |
|  | 1. Save |
|  |  |

### 业务规则

|  |  |
| --- | --- |
| **Function** | **Rule** |
| 2、SFC | *参考：*  *10: ICT*  *15: SA1 Test*  *19: PCA Cosmetic*  *20: PCA Repair Input*  *33: MB Dismantled*  *NWC：21 BGA Input* |
| 4、Display [MB Sno] and Get [Repair List] By [MBSno] | 1、[MBSno]  2、[Repair List]  参考方法：  select SnoId as MBSno,Remark,Username,Cdt,Udt from rpt\_PCARep nolock where Tp='BGA' and SnoId=@MBSNo order by Cdt |
| 5、Save | 1、更新过站记录  Update PCBStatus  Status = ‘1’  Station = ‘21’  2、记录过站Log  Insert PCBLog  Status = ‘1’  Station = ‘21’ |

# Appendix

## Question